

证券代码：000636

证券简称：风华高科

广东风华高新科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中金公司、永安国富、Willing Capital、Cloud Alpha Capital、东方证券、安信证券、陆宝资管、宁银理财、中泰证券、禹合资产、微宇基金、竣弘投资、恒阔投资、嘉应控股、瑰钰投资、南地资本、东方港湾、平安证券、平安资管、万和资管、天风证券、易同投资、恒泰自营、睿思资本、旌安投资、盈亚证券等
时间	2023年2月16日 15:00 2023年2月17日 9:30
地点	广东省肇庆市风华路18号风华电子城公司会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书殷健、证券事务部
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司情况</p> <p>公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售，主营产品包括 MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料等产品，产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022 年公司大力推动内部变革，多措并举苦练内功，坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点，促进内部管控，优化架构，降低生产成本。2023 年公司仍将持续加大研发投入，通过引育高端人才、加快高端研发平台建设、实施研发体系改革等措施积极布局高端路线。聚焦材料研发、产品工艺、核心装备全面攻坚，提升高端产品研发时效，不断提升高端产品产出率、高端材料自产化率、高端设备国产化率。</p>

二、投资者问答交流

1. 公司车规产品的研发和推广计划？

答复：公司在国内厂商中属于较早一批布局汽车电子行业的被动元件厂商，MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品已通过 AEC-Q200、IATF 16949 车用体系认证，公司紧抓新能源汽车高速发展的“窗口期”，加速产品研发和市场推广，拥有国内外汽车电子客户并持续加深合作，同时积极开拓和推进汽车电子新客户产品认证工作，并将持续推进更多车用高端阻容产品开发。

2. 随着消费逐步复苏，2023 年 MLCC 产品价格是否会大幅反弹？公司价格策略如何？

答复：从历史数据分析，MLCC 产品价格变化受供需影响存在周期波动。公司的产品价格策略主要结合市场供需关系、客户及产品结构等综合因素制定，未来的走势仍然与市场供需密切关联。公司一直以来高度重视技术创新和研发投入，未来将进一步加大高附加值产品的比重，通过提升技术水平、优化产品结构、提高现场管理水平等持续提升产品盈利能力。

3. 公司募投资项目进度情况？

答复：电阻募投资项目“新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”已满足设计产能规划要求，公司将对电阻的高端产品产出以及产品结构做进一步的优化调整；祥和项目一期月产能 50 亿只已达产，公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进项目产能建设。

4. 公司目前降本增效的举措有哪些？

答复：公司以“三精管理”为主线，以“降本控费”为抓手，推动企业提质增效。一是持续优化现场管理，推行降成本项目；二是持续推进采购精细化管理，通过开展优化供应商结构、推进低成本材料替代、提升材料自产化率等降低采购成本；三是持续优化用工配置，通过合理配置人力资源、优化员工结构等降低人工成本。

5. 公司主要做哪些电子材料？自供情况如何？

	<p>答复：公司电子材料产品主要包括陶瓷粉料、金属粉体材料、电子浆料等系列产品，应用于 MLCC、片阻及电感等电子元器件产品，公司将持续推进 MLCC 及片阻等产品关键材料的开发应用，通过自主研发和产业链战略合作等模式提升材料的国产化和自产化比例。</p> <p>6. 公司在人才引进方面有无限制？</p> <p>答复：人才是公司战略实施的核心要素，公司一直高度重视人力资源建设，结合企业发展需要持续强化人才战略，在人才招聘上聚焦高层次人才引育，并通过持续强化劳动、人事、分配“三项制度”改革等，激发团队干事创业的活力，加快优化人才梯队建设，为公司高质量发展提供强有力的人才保障，近年来持续引进国内外行业专家、顾问、技术团队，以增强公司的研发实力与技术储备。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 2 月 19 日